

1. 高温高湿試験によるウイスカ評価試験

2015年12月21日
株式会社 オサダ



1. 供試品

(1)プリント基板用端子台(各 6 個)

OP-930、OP-910、OP-1100、OP-1500、OTB-620-B-5P、OTB-121-B-5P、OTB-1100NS-B-6P
OTB-910-B-5P、OULP-948-B-5P

(2)ネジ端子(各 6 個)

OT-017、OP-476-1、OT-009-M3-14.1、OT-016-M5、OT-048、OT-048

(3)三価クロメート結線ビス(10 個)

2. 試験期間

2014年11月20日～2015年2月12日

3. 試験基準

IEC 60068-2-82:2007 (JIS C 60068-2-82:2009)

4. 試験条件

(1)前処理 (はんだ熱処理)

- ・使用はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu
- ・使用フラックス: タムラ化研株式会社 EC-19S-8
- ・はんだ温度: 260°C
- ・浸漬深さ: 4mm

(2)試験温度・湿度

温度: 55°C 湿度: 85%RH 時間: 2000H

5. ウイスカ測定

(1)測定器

オリンパス株式会社 DSX 100 マイクロスコープ

(2)測定倍率

108 倍

6. 測定結果

(1)プリント基板用端子台・ネジ端子

100 μ m 以下

(2)三価クロメート結線ビス

50 μ m 以下

以上